

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/国内・株式	
信託期間	信託期間は2024年1月29日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	半導体関連日本株式戦略ファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	半導体関連日本株式戦略マザーファンド	わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	半導体関連日本株式戦略ファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	半導体関連日本株式戦略マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

半導体関連 日本株式戦略ファンド (愛称:半導体ジャパン)

運用報告書(全体版)

第1期(決算日 2025年1月27日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせお取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指數に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指數の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株組入比率	株先物比率	純総資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率			
設定日(2024年1月29日)	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	百万円 3,071
第1期(2025年1月27日)	9,479	0	△5.2	98.9	—	28,524

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「貢建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		株組入比率	株先物比率
		騰 落 率		
(設 定 日) 2024年 1月29日	円 10,000	% —	% —	% —
1月末	10,042	0.4	98.7	—
2月末	11,057	10.6	98.9	—
3月末	11,321	13.2	98.4	—
4月末	10,731	7.3	98.7	—
5月末	10,775	7.8	98.6	—
6月末	11,216	12.2	98.6	—
7月末	10,387	3.9	98.9	—
8月末	9,698	△3.0	98.8	—
9月末	9,339	△6.6	98.3	—
10月末	9,791	△2.1	98.5	—
11月末	9,069	△9.3	98.5	—
12月末	9,365	△6.4	98.8	—
(当 期 末) 2025年 1月27日	9,479	△5.2	98.9	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。

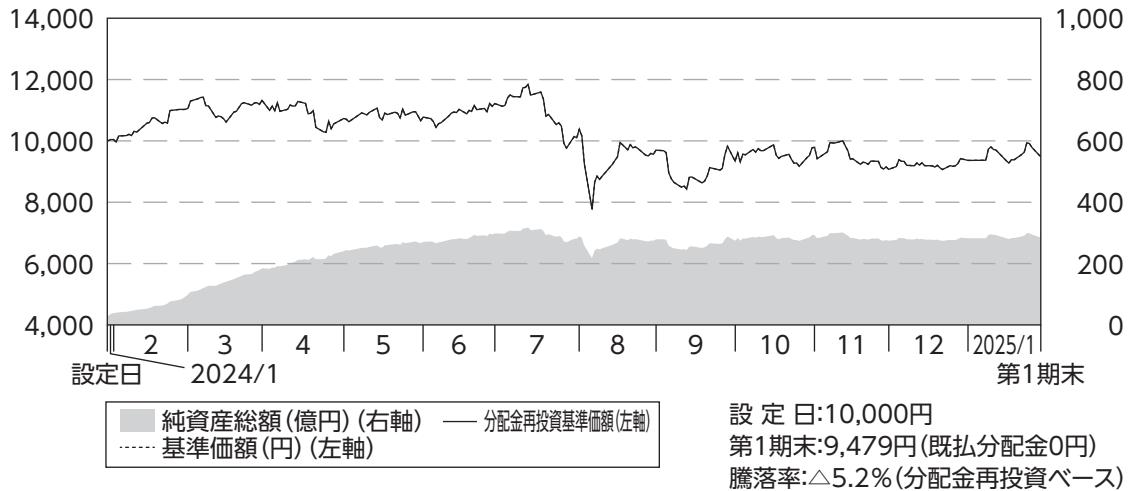
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「貢建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額は、2024年1月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期末の基準価額は、設定日比で下落しました。

国内株式市場は、為替の円安・米ドル高進行を背景に2024年4月にかけて上昇しました。その後、中東情勢が懸念される局面がありましたが、7月前半にかけて再び円安が進行し、株式市場は堅調に推移しました。しかし、7月末に日銀が利上げを決定したことや米国景気の減速懸念を背景に急速な円高・米ドル安が進行すると、株式市場の不確実性の高まりから大幅に下落しました。8月中旬以降は、底堅い企業業績が評価されて値を戻す展開となりましたが、期末にかけて、日米における重要な政治イベントを背景に一進一退の展開が続きました。

半導体関連株式については、米国による対中半導体規制など、業界環境を巡る不透明感が高い状況が継続しました。

このような環境下、アドバンテスト、MARUWA、ディスコなどの株価上昇が基準価額にプラス寄与しました。一方、レーザーテック、イビデン、堀場製作所などの株価下落が基準価額にマイナスに影響しました。

投資環境

当期の国内株式市場は上昇しました。為替の円安・米ドル高進行を背景に2024年4月にかけて上昇しました。その後、中東情勢が懸念される局面がありました。7月前半にかけて再び円安が進行し、株式市場は堅調に推移しました。しかし、7月末に日銀が利上げを決定したことや米国景気の減速懸念を背景に急速な円高・米ドル安が進行すると、株式市場の不確実性の高まりから大幅に下落しました。8月中旬以降は、底堅い企業業績が評価されて値を戻す展開となりましたが、期末にかけて、日米における重要な政治イベントを背景に一進一退の展開が続きました。

半導体関連株式については、米国による対中半導体規制など、業界環境を巡る不透明感が高い状況が継続しました。

当ファンドのポートフォリオ

株式への投資は「半導体関連 日本株式戦略マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。

【「半導体関連 日本株式戦略マザーファンド」の運用経過】

半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等、半導体産業から業績面で恩恵を受ける半導体関連銘柄成長が期待できる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築しています。

当期は、SCREENホールディングス、PILLAR、リンテックなどを新規に購入しました。一方で、SMC、エンプラス、京セラなどを全売却しました。

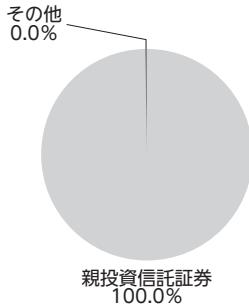
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

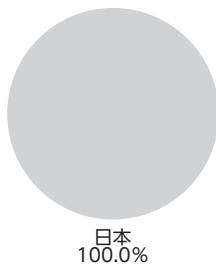
	当期末
	2025年1月27日
半導体関連 日本株式戦略マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

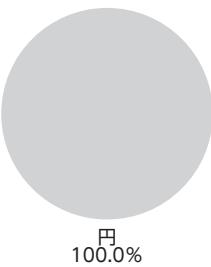
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第1期	
	2024年1月29日～2025年1月27日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	14	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(注3)ー印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

半導体関連 日本株式戦略マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資します。

半導体関連企業を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年1月29日～2025年1月27日)			
	金額	比率		
(a)信託報酬	159円	1.558%	(a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,232円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン ドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価	
(投信会社)	(77)	(0.757)		
(販売会社)	(77)	(0.757)		
(受託会社)	(4)	(0.044)		
(b)売買委託手数料	12	0.117	(b)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕 〔期中の平均受益権口数〕×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株式)	(12)	(0.117)		
(新株予約権証券)	(一)	(一)		
(オプション証券等)	(一)	(一)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(一)	(一)		
(投資信託証券)	(一)	(一)		
(商品)	(一)	(一)		
(先物・オプション)	(一)	(一)		
(c)有価証券取引税	—	—	(c)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕 〔期中の平均受益権口数〕×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取 引に関する税金	
(株式)	(一)	(一)		
(新株予約権証券)	(一)	(一)		
(オプション証券等)	(一)	(一)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(一)	(一)		
(公社債)	(一)	(一)		
(投資信託証券)	(一)	(一)		
(d)その他費用	1	0.006	(d)その他費用=〔期中のその他費用〕 〔期中の平均受益権口数〕×10,000	
(保管費用)	(一)	(一)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証 券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費 用	
(監査費用)	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人に支払うファンダの監査に係る 費用	
(その他)	(一)	(一)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	172	1.681		

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンダが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンダに対応するものを含みます。

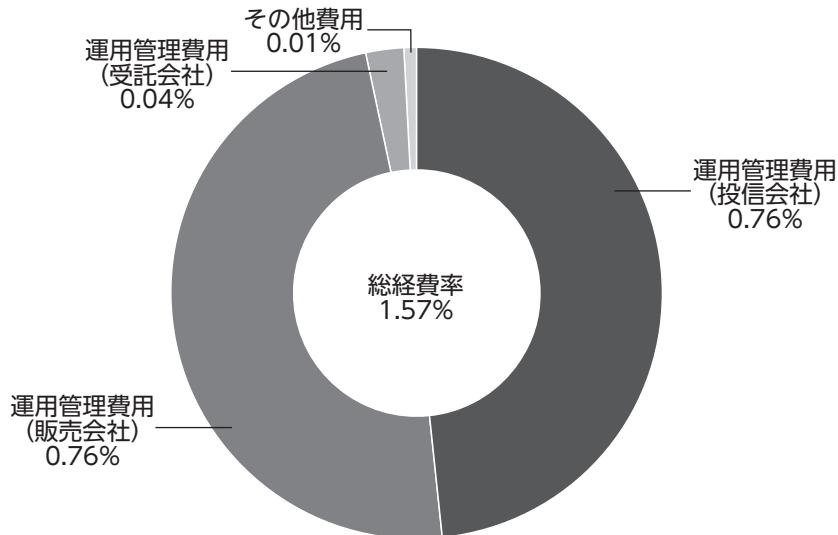
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経费率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経费率(年率)は1.57%です。



(注1)各費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

〈親投資信託受益証券の設定、解約状況〉

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
半導体関連 日本株式戦略マザーファンド	千口 30,042,602	千円 32,267,746	千口 556,561	千円 541,591

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

〈半導体関連 日本株式戦略マザーファンド〉

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	50,962,835千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	23,214,148千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	2.19

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
金 銭 信 託	百万円 0.431692	百万円 0.431692	% 100.0	百万円 0.431692	百万円 0.431692	% 100.0
コール・ローン	25,966	5,347	20.6	25,717	5,314	20.7

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

〈半導体関連 日本株式戦略マザーファンド〉

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
金 銭 信 託	百万円 4	百万円 4	% 100.0	百万円 4	百万円 4	% 100.0
コール・ローン	127,524	19,729	15.5	127,259	19,694	15.5

<平均保有割合 100.0%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

〈親投資信託残高〉

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
半導体関連 日本株式戦略マザーファンド	千口 29,486,041	千円 28,515,950

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、29,486,041千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
半導体関連 日本株式戦略マザーファンド	千円 28,515,950	% 98.8
コール・ローン等、その他	333,662	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	28,849,612	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年1月27日現在
(A) 資産	28,849,612,722円
コール・ローン等	248,145,968
半導体関連 日本株式戦略マザーファンド(評価額)	28,515,950,298
未収入金	85,513,294
未収利息	3,162
(B) 負債	324,984,523
未払解約金	107,602,581
未払信託報酬	216,619,274
その他の未払費用	762,668
(C) 純資産総額(A-B)	28,524,628,199
元本	30,092,391,064
次期繰越損益金	△1,567,762,865
(D) 受益権総口数	30,092,391,064口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,479円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年1月29日 至 2025年1月27日
(A) 配当等収益	176,666円
受取利息	176,773
支払利息	△107
(B) 有価証券売買損益	△3,044,540,450
売買益	163,316,364
売買損	△3,207,856,814
(C) 信託報酬等	△376,778,817
(D) 当期損益金(A+B+C)	△3,421,142,601
(E) 追加信託差損益金	1,853,379,736
(配当等相当額)	(△65)
(売買損益相当額)	(1,853,379,801)
(F) 計	△1,567,762,865
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△1,567,762,865
追加信託差損益金	1,853,379,736
(配当等相当額)	(43,316,027)
(売買損益相当額)	(1,810,063,709)
繰越損益金	△3,421,142,601

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は3,071,269,835円、期中追加設定元本額は28,575,036,785円、期中一部解約元本額は1,553,915,556円です。

※分配金の計算過程

項目	当期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	一円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	一円
(C) 収益調整金額	43,316,027円
(D) 分配準備積立金額	一円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	43,316,027円
(F) 期末残存口数	30,092,391,064口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	14円
(H) 分配金額(1万口当たり)	一円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	一円

お知らせ

該当事項はありません。

半導体関連 日本株式戦略マザーファンド

運用報告書

第1期（決算日 2025年1月27日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2024年1月29日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	純 資 産 額
	期	騰	中			
設 定 日 (2024年1月29日)	円 10,000	% —		% —	% —	百万円 3,069
第1期(2025年1月27日)	9,671	△3.3		98.9	—	28,516

(注)株式先物比率は「賃建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額			株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	物 率
	騰	落	率			
(設 定 日) 2024年 1月29日	円 10,000	% —		% —	% —	% —
1月末	10,052	0.5		98.7	—	—
2月末	11,137	11.4		99.0	—	—
3月末	11,426	14.3		98.4	—	—
4月末	10,829	8.3		98.7	—	—
5月末	10,890	8.9		98.6	—	—
6月末	11,349	13.5		98.7	—	—
7月末	10,522	5.2		99.0	—	—
8月末	9,831	△1.7		98.9	—	—
9月末	9,479	△5.2		98.3	—	—
10月末	9,952	△0.5		98.6	—	—
11月末	9,229	△7.7		98.5	—	—
12月末	9,543	△4.6		98.8	—	—
(当 期 末) 2025年 1月27日	9,671	△3.3		98.9	—	—

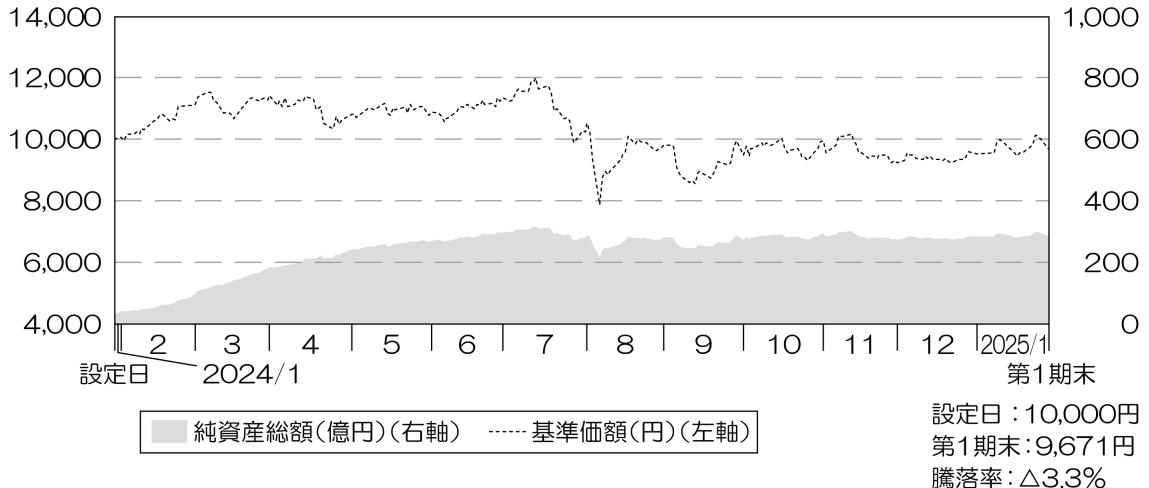
(注1)騰落率は設定日比です。

(注2)株式先物比率は「賃建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

当期末の基準価額は、設定日比で下落しました。

国内株式市場は、為替の円安・米ドル高進行を背景に2024年4月にかけて上昇しました。その後、中東情勢が懸念される局面がありましたが、7月前半にかけて再び円安が進行し、株式市場は堅調に推移しました。しかし、7月末に日銀が利上げを決定したことや米国景気の減速懸念を背景に急速な円高・米ドル安が進行すると、株式市場の不確実性の高まりから大幅に下落しました。8月中旬以降は、底堅い企業業績が評価されて値を戻す展開となりましたが、期末にかけて、日米における重要な政治イベントを背景に一進一退の展開が続きました。

半導体関連株式については、米国による対中半導体規制など、業界環境を巡る不透明感が高い状況が継続しました。

このような環境下、アドバンテスト、MARUWA、ディスコなどの株価上昇が基準価額にプラス寄与しました。一方、レーザーテック、イビデン、堀場製作所などの株価下落が基準価額にマイナスに影響しました。

投資環境

当期の国内株式市場は上昇しました。為替の円安・米ドル高進行を背景に2024年4月にかけて上昇しました。その後、中東情勢が懸念される局面がありましたが、7月前半にかけて再び円安が進行し、株式市場は堅調に推移しました。しかし、7月末に日銀が利上げを決定したことや米国景気の減速懸念を背景に急速な円高・米ドル安が進行すると、株式市場の不確実性の高まりから大幅に下落しました。8月中旬以降は、底堅い企業業績が評価されて値を戻す展開となりましたが、期末にかけて、日米における重要な政治イベントを背景に一進一退の展開が続きました。

半導体関連株式については、米国による対中半導体規制など、業界環境を巡る不透明感が高い状況が継続しました。

当ファンドのポートフォリオ

半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等、半導体産業から業績面で恩恵を受ける半導体関連銘柄成長が期待できる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築しています。

当期は、SCREENホールディングス、PILLAR、リンテックなどを新規に購入しました。一方で、SMC、エンプラス、京セラなどを全売却しました。

当ファンドの組入資産の内容

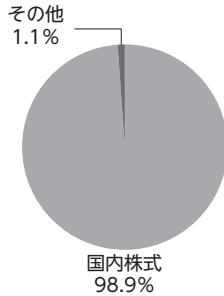
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	東京エレクトロン	日本	5.8%
2	MARUWA	日本	5.8%
3	ディスコ	日本	5.7%
4	アドバンテスト	日本	5.1%
5	イビデン	日本	4.7%
6	トリケミカル研究所	日本	4.6%

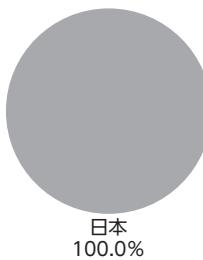
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ダイフク	日本	4.5%
8	レゾナック・ホールディングス	日本	4.2%
9	ローツェ	日本	3.7%
10	フジミインコーポレーテッド	日本	3.6%
組入銘柄数			43

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

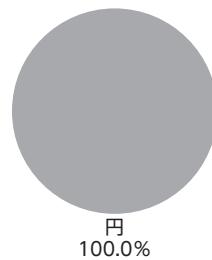
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資します。

半導体関連企業を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年1月29日～2025年1月27日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料	12円	0.117%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株式)	(12)	(0.117)		
(新株予約権証券)	(一)	(一)		
(オプション証券等)	(一)	(一)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(一)	(一)		
(投資信託証券)	(一)	(一)		
(商品)	(一)	(一)		
(先物・オプション)	(一)	(一)		
(b) 有価証券取引税	—	—	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株式)	(一)	(一)		
(新株予約権証券)	(一)	(一)		
(オプション証券等)	(一)	(一)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(一)	(一)		
(公社債)	(一)	(一)		
(投資信託証券)	(一)	(一)		
(c) その他費用	—	—	(c) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$	
(保管費用)	(一)	(一)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用	
(監査費用)	(一)	(一)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用	
(その他)	(一)	(一)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	12	0.117		

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注2)各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準額(10,353円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

〈株式〉

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 7,482 (1,100)	千円 41,349,254 (-)	千株 1,831	千円 9,613,581

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

株式売買比率

〈株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合〉

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	50,962,835千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	23,214,148千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	2.19

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 4	百万円 4	% 100.0	百万円 4	百万円 4	% 100.0
コール・ローン	127,524	19,729	15.5	127,259	19,694	15.5

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

* 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期末		銘柄	当期末	
	株数	評価額		株数	評価額
食料品(0.5%)			千株	千円	
味の素	22.2	140,170	ソシオネクスト	77.2	199,523
化学(23.3%)			芝浦メカトロニクス	105.4	884,306
レゾナック・ホールディングス	308.4	1,207,386	サンケン電気	60.3	371,689
日産化学	84.6	402,949	ルネサスエレクトロニクス	177.8	376,669
信越化学工業	118.4	609,641	ソニーグループ	272.6	888,948
東京応化工業	264	976,008	マイコー	25	213,750
住友ベークライト	266.3	1,011,407	アドバンテスト	159.3	1,463,170
扶桑化学工業	14.7	50,127	レーザーテック	12.9	195,822
トリケミカル研究所	390	1,302,600	ローム	89.7	137,151
太陽ホールディングス	57.8	249,696	S C R E E N ホールディングス	66.8	714,760
富士フィルムホールディングス	27.1	92,140	東京エレクトロン	64.3	1,659,261
東洋合成工業	40	212,800	精密機器(5.9%)		
メッツ	133.5	445,890	東京精密	89.6	675,315
ガラス・土石製品(10.6%)			H O Y A	19.5	417,202
日東紡績	54.8	316,744	A & D ホロンホールディングス	296.7	560,466
MARUWA	36.5	1,654,545	その他製品(2.1%)		
フジミインコーポレーテッド	452.7	1,033,061	TOPPAN ホールディングス	25.8	114,371
金属製品(2.5%)			リンテック	161.2	476,346
S U M C O	362.2	440,435	卸売業(1.0%)		
R S T e c h n o l o g i e s	85	257,975	マクニカホールディングス	155.4	285,159
機械(21.7%)			サービス業(1.0%)		
ディスコ	34.7	1,616,326	ジャパンマテリアル	157.4	273,561
ローツエ	614.5	1,064,314	合計 株数・金額	6,751	28,199,482
荏原製作所	264.2	700,922	合計 銘柄数<比率>	43	<98.9%>
オルガノ	118.9	957,145	(注1)銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。		
ダイワク	401.8	1,287,769	(注2)合計欄の()内は、純資産総額に対する評価額の比率です。		
P I L L A R	116.2	506,051			
電気機器(31.4%)					
イビデン	279	1,336,968			
KOKUSAI ELECTRIC	186.9	418,936			

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
コール・ローン等、その他	28,199,482	97.9
投資信託財産総額	617,838	2.1
	28,817,320	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年1月27日現在
(A) 資産	28,817,320,466円
コール・ローン等式(評価額)	265,017,379
株式	28,199,482,550
未収入金	288,029,760
未収配当金	64,787,400
未収利息	3,377
(B) 負債	301,307,809
未払本金	215,794,515
未払解約金	85,513,294
(C) 純資産総額(A-B)	28,516,012,657
元本	29,486,041,049
次期繰越損益金	△970,028,392
(D) 受益権総口数	29,486,041,049口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,671円

■損益の状況

項目	当期 自2024年1月29日至2025年1月27日
(A) 配当等収益	326,047,846円
受取配当金	325,543,589
受取利息	515,584
その他の収益金	14
支払利息	△11,341
(B) 有価証券売買損益	△3,536,191,040
売買益	2,115,413,204
売買損	△5,651,604,244
(C) 当期損益金(A+B)	△3,210,143,194
(D) 追加信託差損益金	2,225,144,575
(E) 解約差損益金	14,970,227
(F) 計(C+D+E)	△970,028,392
次期繰越損益金(F)	△970,028,392

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (D) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (E) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は3,069,734,200円、期中追加設定元本額は26,972,868,163円、期中一部解約元本額は556,561,314円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

半導体関連 日本株式戦略ファンド

29,486,041,049円

お知らせ

該当事項はありません。